

【表紙】

【提出書類】	四半期報告書の訂正報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の7第4項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成28年10月28日
【四半期会計期間】	第51期第3四半期(自平成25年10月1日至平成25年12月31日)
【会社名】	東京エレクトロン株式会社
【英訳名】	Tokyo Electron Limited
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 河合利樹
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂五丁目3番1号
【電話番号】	03(5561)7000
【事務連絡者氏名】	経理部長 小俣良二
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂五丁目3番1号
【電話番号】	03(5561)7000
【事務連絡者氏名】	経理部長 小俣良二
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成 26 年 2 月 7 日に提出いたしました第 51 期第 3 四半期(自 平成 25 年 10 月 1 日 至 平成 25 年 12 月 31 日) 四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

<訂正の経緯及び理由>

当社米国子会社 Tokyo Electron America, Inc.(以下「TEA」といいます)におきまして、受注高及び受注残高の集計プログラムに不具合があり、これにより当社が毎四半期に公表してきた連結受注高及び連結受注残高の数値に誤りが生じていたことが判明しました。TEA が当該集計プログラムを導入した平成 17 年当時から、当社の毎四半期の連結受注高に対して 0.4%過少～1.9%過剰の範囲で誤差が生じており、これらの差額が継続して積み上がった結果、平成 28 年 6 月末における受注残高は、当社の連結受注残高の 2.8%に相当する約 104 億円が過剰に計上されておりました。

この集計プログラムは、販売系の基幹システムのデータから受注高及び受注残高を集計するために TEA が独自に開発したものであり、特定の取引事象については、受注データを二重に集計してしまう不具合が生じていました。TEA 以外では当該集計プログラムは使用しておらず、他の海外現地法人の受注高及び受注残高に誤りがないかも調査いたしましたが、TEA 以外では問題がないことを確認しました。

今般、プログラム上の不具合の原因究明に至り、その誤ったロジックを修正して訂正後の受注高及び受注残高の算出を行いましたので、訂正するものであります。なお、前述のとおり、平成 17 年以降に当社が公表してきた連結受注高及び連結受注残高に誤りが認められるものの、有価証券報告書及び四半期報告書の一部訂正に関しましては、有価証券報告書及び四半期報告書の公衆縦覧期間及び修正額の影響度に鑑み、有価証券報告書については過去 5 年間、四半期報告書については過去 3 年間の公表分を対象とすることといたします。

2 【訂正事項】

第一部 企業情報

第 2 事業の状況

3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4) 生産、受注及び販売の実績

3 【訂正箇所】

訂正箇所は__を付して表示しております。

第一部 【企業情報】

第2 【事業の状況】

3 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(4) 生産、受注及び販売の実績

(訂正前)

(省略)

② 受注実績

当第3四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高(百万円)	前年同期比(%)	受注残高(百万円)	前年同期比(%)
半導体製造装置	<u>392,526</u>	<u>67.5</u>	<u>237,292</u>	<u>66.3</u>
F P D製造装置	24,729	70.3	22,522	51.4
P V製造装置	3,733	—	7,744	△8.1
電子部品・情報通信機器	75,133	21.5	17,102	21.7
その他	334	9.8	—	—
合計	<u>496,458</u>	<u>59.6</u>	<u>284,663</u>	<u>58.1</u>

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 P V製造装置の受注高の前年同期比は、1000%を超えているため記載しておりません。

(省略)

(訂正後)

(省略)

② 受注実績

当第3四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高(百万円)	前年同期比(%)	受注残高(百万円)	前年同期比(%)
半導体製造装置	<u>392,481</u>	<u>67.7</u>	<u>236,431</u>	<u>66.8</u>
F P D製造装置	24,729	70.3	22,522	51.4
P V製造装置	3,733	—	7,744	△8.1
電子部品・情報通信機器	75,133	21.5	17,102	21.7
その他	334	9.8	—	—
合計	<u>496,412</u>	<u>59.7</u>	<u>283,801</u>	<u>58.5</u>

(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3 P V製造装置の受注高の前年同期比は、1000%を超えているため記載しておりません。

(省略)